



#### RE470

- Epoxyd FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopmmaske beschichtet
- Pitch 0,40 mm (15,7 mil) und 0,50 mm (19,7mil)
- Adaptionsplatine für 23 verschiedene SMD-QFPs
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Gerberdaten zur Herstellung der Lötstopmmaske und des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt
- Größe 132,00 x 203,00 mm

| Modul-Nr. | Pitch      | Pin          | mil  | Größe (mm)                   |
|-----------|------------|--------------|------|------------------------------|
| RE470-01  | S 0,500 mm | QFP 40, 48   | 19,7 | 7,00 x 7,00                  |
|           | S 0,400 mm | QFP 80       | 15,7 | 10,00 x 10,00                |
| RE470-02  | S 0,500 mm | QFP 80       | 19,7 | 12,00 x 12,00                |
|           | S 0,400 mm | QFP 100, 108 | 15,7 | 12,00 x 12,00                |
| RE470-03  | R 0,500 mm | QFP 120, 128 | 19,7 | 14,00 x 20,00                |
|           | R 0,400 mm | QFP 100, 108 | 15,7 | 10,00 x 14,00                |
| RE470-04  | S 0,500 mm | QFP 72, 100  | 19,7 | 10,00 x 10,00                |
|           | S 0,400 mm | QFP 12       | 15,7 | 14,00 x 14,00                |
| RE470-05  | S 0,500 mm | QFP 144, 176 | 19,7 | 20,00 x 20,00, 24,00 x 24,00 |
|           | S 0,400 mm | QFP 184      | 15,7 | 20,00 x 20,00                |
| RE470-06  | R 0,500 mm | QFP 256, 264 | 19,7 | 28,00 x 40,00                |
|           | R 0,400 mm | QFP 224, 232 | 15,7 | 20,00 x 28,00                |
| RE470-07  | S 0,500 mm | QFP 208, 240 | 19,7 | 28,00 x 28,00, 32,00 x 32,00 |
|           | S 0,400 mm | QFP 264      | 15,7 | 28,00 x 28,00                |